

5. BuS-Fachpodium

# Die gesamte Wertschöpfungskette

Ob man die Leistungsfähigkeit von BuS Elektronik für alle Bereiche der Wertschöpfungskette in Anspruch nimmt oder in einzelnen Segmenten einen kompetenten Partner braucht: Der Elektronikdienstleister aus Riesa hat das Zeug dazu, stets die passende Lösung anbieten zu können – das vermittelte zumindest das 5. BuS-Fachpodium.

Moderne EMS-Dienstleistung umfasst alle Bereiche der Entwicklung und Produktion elektronischer Baugruppen und Systeme. Als Kunde sollte man deshalb die Möglichkeit haben, den Leistungsumfang in Anspruch zu nehmen, der genau den eigenen Vorstellungen entspricht. „Wir liefern nicht von der Stange, sondern fertigen nach Maß,“ betont Dr. Werner Witte (Bild 1), Geschäftsführer der BuS Elektronik in Riesa.

## Die Wertschöpfungskette als Dienstleistung

Zur Zeit zählt der Dienstleister aus Sachsen rund 600 Mitarbeiter. Dabei sind allein 17000 m<sup>2</sup> des 45000 m<sup>2</sup> großen Geländes für die Produktion innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette reserviert. Auf acht Produktionslinien und zahlreichen Produktionsinseln wurden im Jahr 2008 mehr als 2000 unterschiedliche Baugruppen und Systeme mit einer Gesamtfertigungsmenge von 16 Mio. Stück an mehr als 200 Kunden ausgeliefert. Einige wurden bei BuS entwickelt, etliche im Hause layouttechnisch begleitet und für fast alle wurde in Absprache mit dem jeweiligen Kunden ein Testkonzept erarbeitet. In wieder anderen Fällen haben Kunden sich für ein Outsourcing entschieden und uns ihre gesamte Elektronikfertigung anvertraut. Die Fertigung bei BuS ist mit allen modernen Standardausrüstungen eines Elektro-

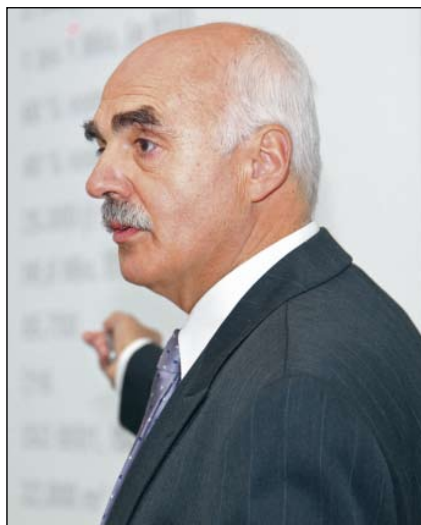


Bild 1: Dr. Werner Witte, Geschäftsführer der BuS Elektronik in Riesa

nik-Dienstleisters ausgestattet. Die Verarbeitungskapazität beträgt derzeit zirka 150000 BE/h.

„Ein strategischer Gesichtspunkt ist dabei, Reserven vorzuhalten, um kurzfristig unsere Fertigungskapazität anzupassen. Unser Versprechen ist die ständige Vorhaltung von 10 bis 20% Kapazitätsreserve zur flexiblen und termintreuen Auftragserfüllung,“ so Witte. „Höhere Bedarfsspitzen decken wir innerhalb weniger Wochen ab. Flexible Arbeitszeitmodelle gewährleisten zusätzlich kurzfristige Reaktionen auf Bedarfsschwankungen.“

Die Verarbeitbarkeit von Komponenten reicht von 0402-Chips über ICs mit 0,4 mm Raster, BGAs, Keramikssubstrate, Flex-Leiterplatten, übergroße Leiterplatten (610 mm x 534 mm), Abschirmbleche, Aluminium-Leiterplatten, etc. bis hin zu vielen exotischen Bauelementen, die



Bild 2: Dr. Werner J. Maiwald, Geschäftsführer der BuS Elektronik in Riesa

oft nur manuell verarbeitet werden können.

## Fertigungsübernahmen sind Vertrauenssache

Damit die Fertigungsverlagerung vom OEM zum Dienstleister zu einer dauerhaften Partnerschaft führt, sind eine gute Vorbereitung und eine gründliche Prüfung des Outsourcing-Partners angeraten. Neben den technischen Voraussetzungen müssen auch die Soft Facts nachhaltig zusammenpassen. Der Begriff Partnerschaft nimmt einen hohen Stellenwert ein. Mit einem Einkaufsvolumen von aktuell mehr als 60 Mio. Euro können die Dienstleister aus Riesa günstigste Materialpreise anbieten. Darüber hinaus bietet man komplette Logistikaufgaben an, wie z. B. Kanban-Lösungen mit der elektronischen Übertragung der Bedarfszahlen, ►

**AUTOR**

Hilmar Beine,  
Chefredakteur  
productronic



Bild 3: Interessierte Zuhörer beim 5. BuS-Fachpodium



Bild 4: Podiumsdiskussion mit Kunden und Gästen



Bild 5: Das BuS-Areal in Riesa

Konsignationslager, die sowohl als externe Kundenlager als auch bei BuS Elektronik eingerichtet werden.

## Das 5. BuS-Fachpodium

Im Kreis ausgesuchter Kunden und Gäste (Bild 3) veranstaltete die BuS Elektronik ihr mittlerweile 5. BuS-Fachpodium mit Beiträgen, einer Podiumsdiskussion und einem Fertigungsrundgang, der jede Men-

ge Möglichkeit zu Fragen und Antworten ließ.

## Die Technologien der Zukunft

Zu diesem Thema referierte Prof. Mathias Nowottnick (mathias.nowottnick@uni-rostock.de), Universität Rostock, Direktor des Institutes für Gerätesysteme und Schaltungstechnik. Dabei gibt es viele technologischen Entwicklungen, die auch

die Elektronik verändern könnten, wie z. B. Nanomaterialien oder das Mikrowellenlöten, vielleicht integriert in eine konventionelle Reflowlötanlage.

Die selektive Kühlung mittels Glycerin oder Parafin könnte zum Einsatz kommen. Man nutzt dabei die Enthalpie von Flüssigkeiten, also die Verdampfungs- und die Schmelzwärme für so einen selektiven Wärmeprozess. Erste Lacke mit schmelzbaren Füllstoffen sind bereits in der Erprobung.

Embed Flipchips in der Leiterplatte wären sehr beständig gegen mehrfache Lötzyklen und Reaktionslote könnten für neue sogenannte Diffusionslötverfahren zum Einsatz kommen.

## Der Bauteilemarkt der Zukunft

Kaufen wir zukünftig Bauteile günstiger ein? Dazu äußerte sich Georg Steinberger, Avnet Vice President Communication und Präsident des FBDI. Europa werde für die Halbleiterhersteller immer mehr zum Nischenmarkt. Das ändert sich auch nicht durch die momentane Krise. Aber die Voraussetzungen, mit weniger Blessuren als 2001 wieder in den grünen Bereich zu kommen sehen weitaus besser aus.

## Die Fertigungsstrategie der Zukunft

Warum Kunden durch das BuS-Outsourcing-Konzept bis heute schon über 65 Mio. Euro eingespart haben, diskutierte Dr. S. Weyhe, Geschäftsführer des FED mit Kunden der BuS Elektronik und Gästen (Bild 4).

Nach wie vor gibt es Unternehmen, die auf keinen Fall teilweise oder auch ganz ihre Fertigung outsourcen möchten. Wer sich aber nach reiflicher Überlegung z. B. die BuS Elektronik als Partner herausgesucht hat, ist zufrieden, vor allem auch wenn es kurzfristig um mittlere Serien oder hohe Qualitätsanforderungen geht, die man im eignen Hause nur mühsam erfüllen kann oder ganz einfach, wenn man einen verlässlichen Partner benötigt, der die Fertigung in voller Verantwortung übernehmen kann.

	<b>infoDIRECT</b>	<b>411pr0909</b>
<a href="http://www.productronic.de">www.productronic.de</a>		
▶ <a href="#">Link zu BuS Elektronik</a>		